

Produktdatenblatt

VarPol Stiftleiste gerade 1-reihig,
Art. Nr. 971-nn018-b1

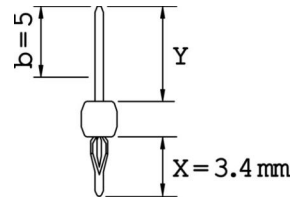


Abbildung ähnlich



Parallel



Einpresstechnik

- Länge Steckseite (Y) = 17.5 mm
- Einpresstechnik
- Anschlusslänge 3.4 mm
- Polzahl 2 - 36 (Polzahl / Reihe entspricht nn in Artikelnummer)
- 1-reihig
- b in Artikelnummer definiert die Gütestufe der Steckseite



» zum Produkt auf www.ept.de



» zur Produktgruppe Varpol connectors

Produktdatenblatt

VarPol Stifftleiste gerade 1-reihig,
Art. Nr. 971-nn018-b1



Technische Daten

Grundlagen

| | |
|----------------------|---------------------|
| Anzahl Kontakte | 2 - 36 |
| Anschluss technik | Einpresstechnik |
| Anschlusslänge | 3.4 mm |
| Leiterplattenabstand | 23.95 mm - 27.95 mm |
| Betriebstemperatur | -55°C bis +125°C |

Material

| | |
|-----------------|-----------------------------------|
| Isolierkörper | PBT glasfaserverstärkt, UL 94 V-0 |
| Kontaktmaterial | Kupferlegierung |

Mechanisch

| | |
|------------------------|------------|
| Rastermaß | 2.54 mm |
| Steckkraft pro Kontakt | max. 0.9 N |
| Ziehkraft pro Kontakt | min 0.6 N |

Elektrisch

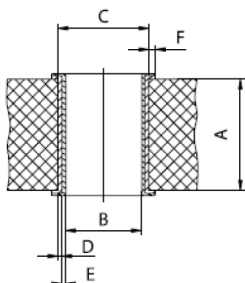
| | |
|-------------------------|----------------------|
| Betriebsstrom | max. 1.9 A |
| Betriebsspannung | 150 V |
| Durchgangswiderstand | < 20 mΩ |
| Luft- und Kriechstrecke | 1.2 mm |
| Isolationswiderstand | > 10 ⁶ MΩ |

Zulassungen / Konformität

| | |
|---------|--------------|
| UL file | E130314 |
| Umwelt | RoHS konform |

Lochspezifikation

Schichtaufbau nach IEC 60352-5



| Material | chem. Sn Leiterplatten |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Nennloch | Ø 1.0 mm |
| A Leiterplattendicke | min 1.44 mm |
| B Endloch | Ø 1.0 +0.09 / -0.06 mm |
| C Grundbohrung | 1.15 ±0.025 mm |
| D Cu Schicht | min. 25 µm |
| E Oberfläche | chem. Sn Schicht, max. 1.5 µm |
| F Restring | min. 0.1 mm |

| Material | Ni, Au Leiterplatten |
|-----------------------------|---|
| Nennloch | Ø 1.0 mm |
| A Leiterplattendicke | min 1.44 mm |
| B Endloch | Ø 1.0 +0.09 / -0.06 mm |
| C Grundbohrung | 1.15 ±0.025 mm |
| D Cu Schicht | min. 25 µm |
| E Oberfläche | Ni, Au Schicht, 0.05 - 0.2 µm Au über 2.5 - 5 µm Ni |
| F Restring | min. 0.1 mm |

| Material | rein Cu Leiterplatten |
|-----------------------------|---|
| Nennloch | Ø 1.0 mm |
| A Leiterplattendicke | min 1.44 mm |
| B Endloch | Ø 1.0 +0.09 / -0.06 mm |
| C Grundbohrung | 1.15 ±0.025 mm |
| D Cu Schicht | min. 25 µm |
| E Oberfläche | OSP, z.B. GLICOAT-SMD (F2) mit 0.12 - 0.15 µm |
| F Restring | min. 0.1 mm |

| Material | HAL Sn Leiterplatten |
|-----------------------------|------------------------|
| Nennloch | Ø 1.0 mm |
| A Leiterplattendicke | min 1.44 mm |
| B Endloch | Ø 1.0 +0.09 / -0.06 mm |
| C Grundbohrung | 1.15 ±0.025 mm |
| D Cu Schicht | min. 25 µm |
| E Oberfläche | HAL Sn, 5 - 15 µm |
| F Restring | min. 0.1 mm |

Produktdatenblatt

VarPol Stiffliste gerade 1-reihig,
Art. Nr. 971-nn018-b1



Zeichnungen

Die Kundenzeichnungen sowie 3D-Daten zu diesem Produkt können Sie hier herunterladen:

[» PDF](#)